

3D積層造形用 銅合金粉末

Copper alloy powder for additive manufacturing



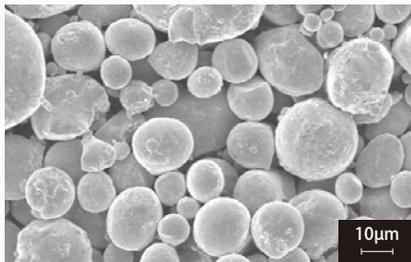
製品概要

Product summary

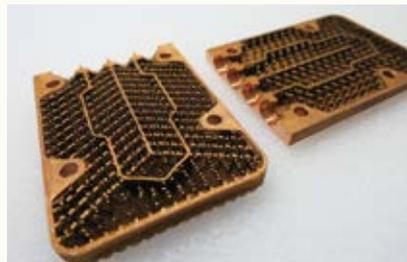
◎銅合金粉と造形レシピをご利用頂く事で、400W程度の低出力レーザー積層造形が可能です
General 3D printing is possible with Cu alloy powder and molding recipe.

◎導電性グレードは純銅の95%の導電率を、強度グレードは純銅の3倍以上の引張強度を、それぞれ有します

The conductive grade has a conductivity of 95% of pure copper, and the strength grade has a tensile strength more than 3 times that of pure copper.



◆ MA-CCR25L ◆



◆ ヒートシンク Heat sink ◆



◆ 水冷トーチ Water cooled torch ◆

製品の詳細データ

Product specification

品番	グレード	粉体特性			造形物特性						
		比表面積	タップ密度	D50	密度	熱伝導率	電気伝導率	引張強度	0.2%耐力	伸び	ヤング率
		m ² /g	g/cm ³	µm	%	W/m·K	% IACS	MPa	MPa	%	GPa
MA-CCR25L	導電性グレード	0.07	5.6	25	>99.5	377	95	316	190	22	112
MA-CCR25H	強度グレード	0.07	5.6	25	>99.5	203	60	755	720	15	124
純銅		—	—	—	—	398	100	195	200	35	117

ビジネスモデル

Business model

